


Versatz / displacement	Toleranz / tolerance
Fräskante zu Bohrungen milled edge to holes	±0.2
Fräskante zu Leiterbild milled edge to conductive pattern	±0.3
Ritzkante zu Bohrungen score edge to holes	±0.3
Bohrungen holes	±0.1
Bohrungen zu Leiterbild holes to conductive pattern	±0.15

- 1) Leiterplatten Gesamtdicke mit Leiterbahnen und Lötstoplack
PC board total thickness with conductor paths and solder resist
- 2) Toleranz für Trennkante: 21.15 ±0.3
tolerance for break edge: 21.15 ±0.3
- 3) Toleranz für Bohrungsabstand (Ø2±0.05): 21.15 ±0.1
tolerance for hole pitch (Ø2±0.05): 21.15 ±0.1
- 4) Bauteilehöhe max. 2.1 mm
component height max. 2.1 mm
- 5) Bauteilehöhe max. 1.6 mm (nicht schraffierter Bereich)
component height max. 1.6 mm (not shaded area)

Toleranz für Kupferstrukturen ±0.127
tolerance for copper structures ±0.127

- Goldkontaktfläche
contact surface gold
- Goldfläche
surface gold
- Sperrfläche für Bauteile (Bauteile können bis an Sperrflächen angrenzen)
blocked surface for components (components can boarder on blocked surfaces)

				Tel.		Massstab 8:1	
				Datum	22.04.10		
				Bearb.	Grassl		
				Gepr.	03.08.16 SK		
				Norm.			
5	Trennkante u. Pats		29.07.2016	Gra.	 DOLPHIN by EnOcean		Blatt 1-
Zust.	Willelung		Datum	Name			X H.

ALS BETRIEBSGEHEIMNIS ANVERTRAUT. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

POPRIETARY DATA, COMPANY CONFIDENTIAL. ALL RIGHTS RESERVED

A40001-V27-A2